

单键单路三段或无极调光触摸灯

● 基本操作功能：

工作电压DC=12V（通过稳压LD0-5.0V），2K Hz，具有带电记忆功能

三段调光：OP1接VSS，上电整机为OFF状态，第一次短触摸25%，第二次50%第三次短触摸100%，第四次关灯，循环，均为突变调光，有省电功能。

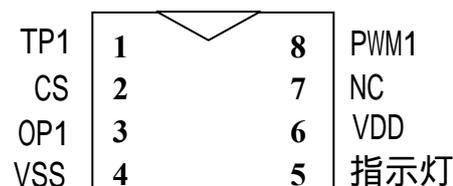
无极调光：

OP1接VDD时，上电整机为OFF状态，触摸第一次输出100%，第二次灭，突变输出；长按无极调光100%-5%，到最暗或最亮后需要手松开后才可以再调光。

指示灯：

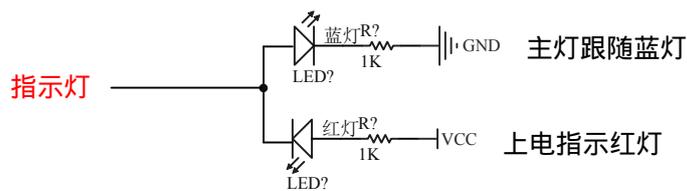
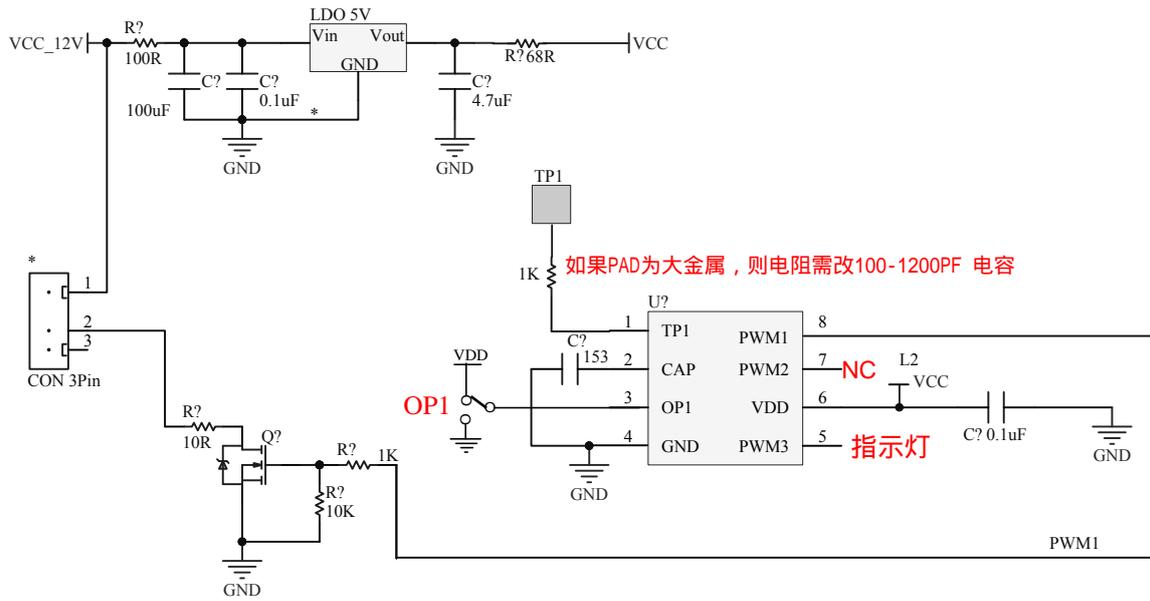
上电红指示灯亮，主灯工作时蓝灯跟随灯亮，红灯灭，即红灯亮时，蓝灯灭，蓝灯亮时红灯灭

● 封装脚位图



SG2908 SOP8

● 应用线路图 款式代号：LW21/BB3D



● AC/DC Characteristics

1 Absolute maximum ratings

Item	Symbol	Rating	Unit
Operating Temperature	Top	-20°C ~ +70°C	°C
Storage Temperature	Tsto	-50°C ~ +125°C	°C
Supply Voltate	VDD	5.5	V
Voltage to input terminal	Vin	Vss – 0.3 to Vdd + 0.3	V

2 D.C. Characteristics

(Condition : Ta= 25 ± 3 °C , RH ≤ 65 % , VDD =+ 5V , VSS=0V)

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Operating voltage	VDD		2.7	5	5.5	V
Operating current	I _{OPR1}	VDD=5V	-	3	-	mA
Input low voltage for input and I/O port	V _{IL1}		0	-	0.3VDD	V
Input high voltage for input and I/O port	V _{IH1}		0.7VDD	-	VDD	V
Output port source current	I _{OH1}	V _{OH} =0.9VDD, @5V	-	4	-	mA
Output port sink current	I _{OL1}	V _{OL} =0.1VDD, @5V	-	8	-	mA

3 A.C. Characteristics

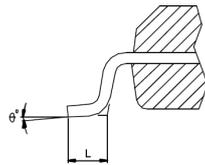
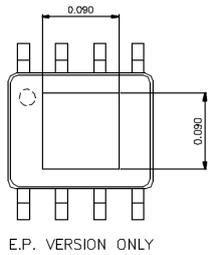
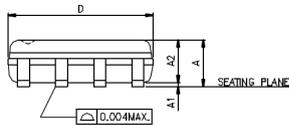
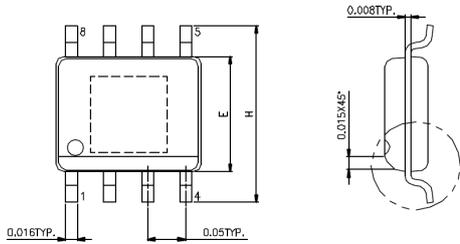
Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
System clock	f _{SYS1}	OSC @5v	-	4	-	MHz
Low Voltage Reset	V _{Ivr}		2.0	2.2	2.4	V

● 注意事项:

1. Cs 电容和灵敏度的关系:
 - ① Cs 电容越小, 触摸灵敏度越低
 - ② Cs 电容越大, 触摸灵敏度越高
 - ③ Cs 电容值范围在 6800pF (682) — 68000pF(683)之间
 - ④ 由于 Cs 量测的电容, 要选择对温度变化系数小, 容值特性稳定的电容材质, 所以须使用 NPO 材质电容或 X7R 材质电容。
2. 电源的布线 (Layout) 方面, 首先要以电路区块划分, 触摸 IC 能有独立的走线到电源正端, 若无法独立的分支走线, 则尽量先提供触摸电路后在连接到其他电路。接地部分也相同, 希望能有独立的分支走线到电源的接地点, 也就是采用星形接地, 如此避免其他电路的干扰, 会对触摸电路稳定有很大的提升效果。
3. 单面板 PCB 设计, 建议使用感应弹簧片作为触摸盘, 以带盘的弹簧片最佳, 触摸盘够大才能获得最佳的灵敏度。
4. 若使用双面 PCB 设计, 触摸盘 (PAD) 可设计为圆形或方形, 一般建议 12mm x 12mm, 与 IC 的联机应该尽量走在触摸感应 PAD 的另外一面; 同时连接线应该尽量细, 也不要绕远路。
5. PCB 和外壳一定要紧密的贴合, 若松脱将造成电容介质改变, 影响电容的量测, 产生不稳定的现象, 建议外壳与 PAD 之间可以采用非导电胶黏合, 例如压克力胶 3M HBM 系列。
6. 为提高灵敏度整体的杂散电容要越小越好, 触摸 IC 接脚与触摸盘之间的走线区域, 在正面与背面都不铺地, 但区域以外到 PCB 的周围则希望有地线将触摸的区域包围起来, 如同围墙一般, 将触摸盘周围的电容干扰隔绝, 只接受触摸盘上方的电容变化, 地线与区域要距离 2mm 以上。触摸盘 PAD 与 PAD 之间距离也要保持 2mm 以上, 尽量避免不同 PAD 的平行引线距离过近, 如此能降低触摸感应 PAD 对地的寄生电容, 有利于产品灵敏度的提高。
7. 电容式触摸感应是将手指视为导体, 当手指靠近触摸盘时会增加对地的路径使杂散电容增加, 藉此侦测电容的变化, 以判断手指是否有触摸。触摸盘与手指所构成的电容变化与触摸外壳的厚度成反比, 与触摸盘和手指覆盖的面积成正比。
8. 外壳的材料也会影响灵敏度, 不同材质的面板, 其介电常数不同, 如 玻璃 > 有机玻璃 (压克力) > 塑料, 在相同的厚度下, 介电常数越大则手指与触摸盘间产生的电容越大, 量测时待测电容的变化越大越容易承认按键, 灵敏度就越高。

● 封装说明

SOP 8



SYMBOLS	MIN.	MAX.
A	0.053	0.069
A1	0.004	0.010
A2	—	0.059
D	0.189	0.196
E	0.150	0.157
H	0.228	0.244
L	0.016	0.050
θ°	0	8

UNIT : INCH

NOTES:

1. JEDEC OUTLINE : MS-012 AA / E.P. VERSION : N/A
2. DIMENSIONS "D" DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD FLASH, PROTRUSIONS AND GATE BURRS SHALL NOT EXCEED .15mm (.006in) PER SIDE.
3. DIMENSIONS "E" DOES NOT INCLUDE INTER-LEAD FLASH, OR PROTRUSIONS. INTER-LEAD FLASH AND PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED .25mm (.010in) PER SIDE.